



2018第三届材料科学与工程国际会议

尊敬的_____先生/女士，您好！

您好！您关注的《2018第三届材料科学与工程国际会议》将于2018年07月在成都召开。

会议内容

会议简介：

2018第三届材料科学与工程国际会议为广大材料科学与工程等相关领域的学者、专家提供交流平台，会议组委会诚邀全球相关领域的学者、专家参加此次国际会议，就材料科学与工程为主题的相关热点问题探讨、交流，共同促进全球材料科学与工程研究的进步与发展。

大会由huiyi123平台举办，huiyi123是一个专业提供国际学术会议交流、论文发表的平台，会议接受中文和英文文章，接受摘要或全文投稿，提供30-60天快速在线出版，论文可被中国知网（CNKI）等知名检索机构检索。

会议主题：材料科学与工程

会议时间：2018年7月25-27日

会议地点：中国，成都

论文出版：

所有的录用论文将由 Science Publishing Group 出版，录用文章出版于如下期刊：

International Journal of Materials Science and Applications (IJMSA)

ISSN Print: 2327-2635 ISSN Online: 2327-2643

Advances in Materials (AM)

ISSN Print: 2327-2503 ISSN Online: 2327-252X

Science Discovery (SD)

ISSN Print: 2331-0642 ISSN Online: 2331-0650

(以上合作期刊可被中知网及部分国外的检索机构检索，如WorldCat, Electronic Journals Library, Zeitschriftendatenbank, EZB, Academickeys, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, Wissenschaftszentrum Berlin等)

会后每篇文章将寄送两本纸质版给国内投稿作者。

会议门票

参会费用(只参会不投稿)

票务类别	包含内容	2018年7月5日前缴费	2018年7月5日后缴费及现场缴费
C票	参会+会议资料+礼品+旅游	1400元	1600元
D票	参会+会议资料+礼品+旅游 +午餐+欢迎晚宴	1800元	2000元

- 1、在线购票支持支付宝、微信及银联支付；
- 2、如果您需要以公对公转账的方式进行购票，收款账号信息如下：
银行帐户：成都云数海量智能科技有限公司
开户银行：中国银行成都中和支行
银行账号：117169457814
购票咨询电话：028-69761252

此致!

